



Cosimo Musca

Presidente di ANIE Componenti Elettronici

- Federazione ANIE rappresenta, nel Sistema Confindustria, le imprese ad alta e medio-alta tecnologia attive nelle filiere dell'**Elettronica** e dell'**Elettrotecnica** e i **General Contractor industriali**.



1.100
imprese
associate



4% incidenza sul fatturato
della spesa in
RICERCA E SVILUPPO



LE IMPRESE SOCIE
77% **23%**
PMI Grandi imprese

Nord Ovest: 48,5%

Nord Est: 23,4%

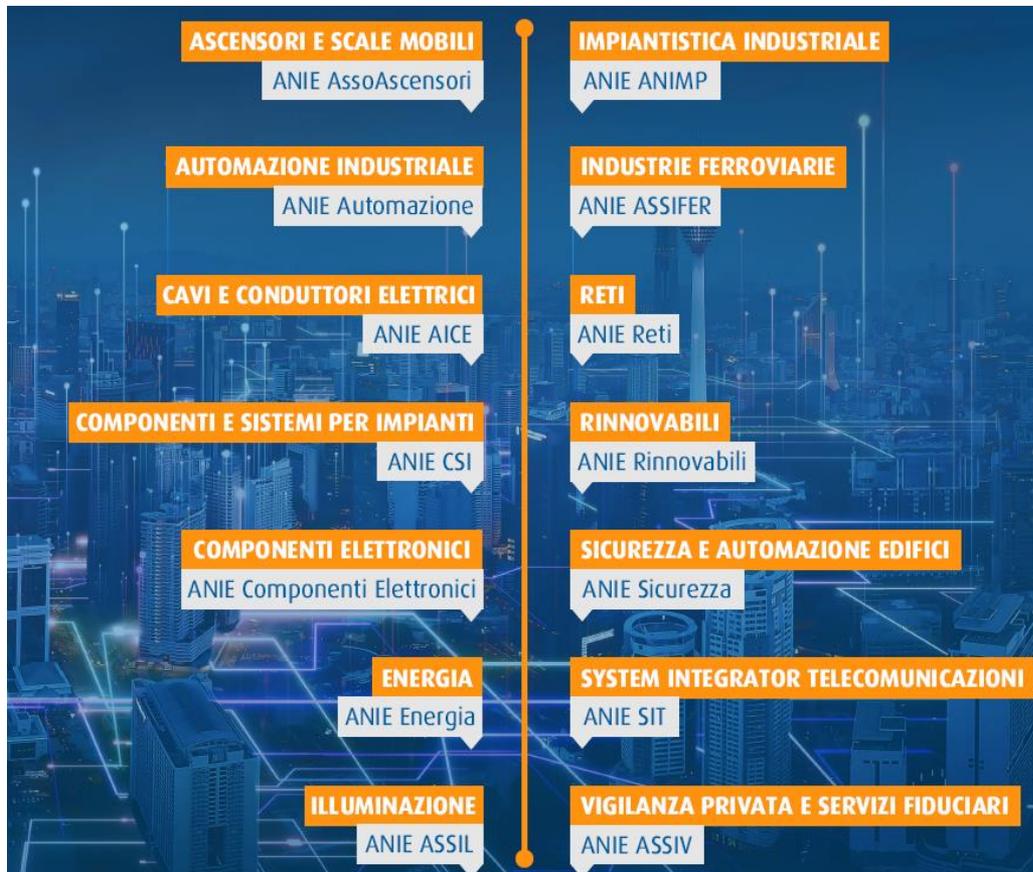
Centro: 14,2%

Sud e Isole: 13,9%



420.000
occupati

- Aderiscono ad ANIE 1.100 imprese raggruppate in **14 Associazioni**.
- ANIE riunisce player strategici che offrono tecnologie all'avanguardia per i mercati:



- ANIE Componenti Elettronici è **espressione dell'industria elettronica italiana** in tutta la sua catena del valore, dalla produzione alla logistica e ai servizi di sviluppo.
- All'interno di Federazione ANIE, l'Associazione ha una **collocazione trasversale** in quanto partecipata da fornitori di tecnologie e servizi per tutti i comparti di ANIE.



221e[∞]

 ANALOG
DEVICES

 **ARROW**
Five Years Out

 **AVNET**[®]
Reach Further™

 **CARLO GAVAZZI**

 **EAT•N**
Powering Business Worldwide

 **DARTON** s.r.l.

 **DAOS**
GROUP

 **EBV Elektronik**
| An Avnet Company |

 **elco**

 **Entity**[®]

 **FAE**
TECHNOLOGY

 **FUTURE**
ELECTRONICS

 **HARTING**

Pushing Performance

 **GlobalWafers**

 **infineon**

 **ITT cannon veam**

 **LEMO**[®]

 **LOGIKA CONTROL**
WE KNOW HOW

 **melchioni**
YOUR TECHNOLOGY

 **molex**

 **NXP**

 **ODU**

 **OPTOI**

 **PHOENIX
CONTACT**

 **PHOENIX
MECANO**

 **RAW POWER**
Soluzioni per l'elettronica di potenza

 **Rosenberger**

 **RS**

 **RUTRONIK**
ELECTRONICS WORLDWIDE

 **SPEA**

 **ST**
life.augmented

 **techno**
TECHNOLOGY & INNOVATION

 **TECNO**
SEN S.p.A.

 **Weidmüller** 

 **WE** **WURTH
ELEKTRONIK**
MORE THAN
YOU EXPECT

 **VISHAY**

Gruppi di Lavoro



Semiconduttori



Distributori



Connettori



Soluzioni Elettroniche

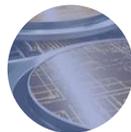
Prossimamente...



Componenti Passivi



PCB Made in Italy



*Macchine per produzione,
collaudo e testing*

**Aree di lavoro
strategiche**



- L'Europa è un continente che ha un ruolo nell'industria internazionale dei semiconduttori. Abbiamo gli elementi per poter competere al meglio partendo dall'**ecosistema europeo**. In questo si innesta la **dinamica nazionale** nella quale noi svolgiamo la nostra azione: lavoriamo allo sviluppo della **filiera industriale**, ma un ruolo chiave lo assume anche la **filiera della conoscenza**.
- Occorre **evitare di seguire un approccio frammentato** che porti ad un debole coordinamento delle priorità e dei requisiti della domanda, ad una mancanza di economia di scala per i produttori interni e ad una minore capacità di investimento nei segmenti più innovativi dei semiconduttori.
- La voce dell'Italia in Europa deve farsi sentire e indirizzare le **evoluzioni del Chips Act** in modo proattivo affinché contemplino i miglioramenti che la filiera italiana della microelettronica necessita.

EUROPEAN CHIPS ACT: i tre pilastri

Comitato europeo sui semiconduttori (Governance)

Pilastro 1 ***Iniziativa Chips for Europe***

- Iniziativa per la costruzione di infrastrutture in sinergia con i programmi di ricerca dell'UE
- Supporto alle Start Up e PMI

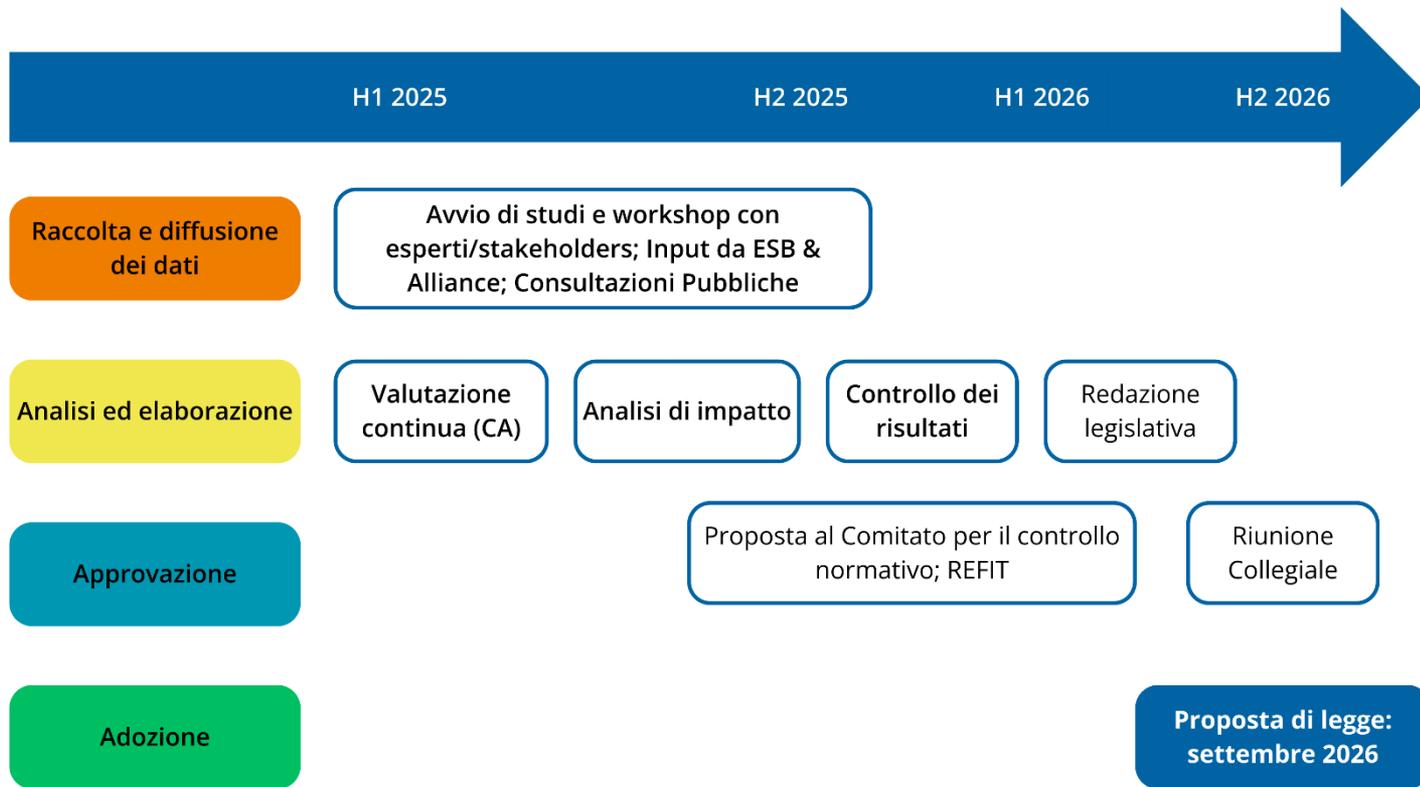
Pilastro 2 ***Sicurezza dell'approvvigionamento***

- First-of-a-kind semiconductor production facilities

Pilastro 3 ***Monitoraggio e risposta alle crisi***

- *Monitoraggio e allertamento*
- *Meccanismo di coordinamento delle crisi fra Stati Membri*
- *Forti poteri alla Commissione in tempo di crisi*

Verso il CHIPS ACT 2.0



Pilastro 1

Iniziativa Chips for Europe

- Iniziativa per la costruzione di infrastrutture in sinergia con i programmi di ricerca dell'UE
- Supporto alle Start Up e PMI

Rappresenta un mondo in cui le imprese sanno muoversi

Proposte migliorative

- Gli IPCEI sono molto visibili ormai, ma non sono dentro l'attuale Chips Act. Nella sua evoluzione 2.0, il Pillar 1 potrebbe contemplarli, in una visione fast track come quella tracciata da Draghi nel rapporto di settembre 2024.

Necessità

- Certezza dei tempi e delle quote di cofinanziamento nazionali.

Rappresenta una novità per le imprese, istituendo un quadro di riferimento per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza del settore dei semiconduttori dell'Unione.

Pilastro 2
Sicurezza
dell'approvvigionamento

- First-of-a-kind semiconductor production facilities

Proposte migliorative

- Puntare alla semplificazione amministrativa e a ridurre i tempi di completamento della procedura di notifica e autorizzazione;
- Confermare e mantenere lo strumento attuale, supportando le nuove ondate di investimenti.

Punto di attenzione

- Il meccanismo attuale per stabilire la necessità di finanziamento (funding gap) non rispecchia i principi imprenditoriali comuni.

Pilastro 3

Monitoraggio e risposta alle crisi

- *Monitoraggio e alertamento*
- *Meccanismo di coordinamento delle crisi fra Stati Membri*
- *Forti poteri alla Commissione in tempo di crisi*

La governance della normativa europea sui chip è supervisionata dal consiglio europeo dei semiconduttori (ESB) che fornisce alla Commissione consulenza, assistenza e raccomandazioni nell'ambito dei tre pilastri d'azione.

Proposta migliorativa

- Prevedere nel Board dell'ESB, che è attualmente composto da rappresentanti degli Stati membri, la rappresentanza industriale

Chapeau

Dimostrare l'ammissibilità e la conformità ai requisiti di comunicazione a livello di IPCEI nel suo complesso e dei suoi obiettivi.

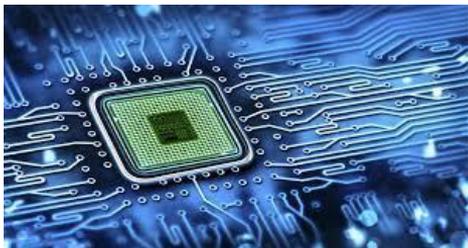
Lo Stato membro coordinatore gestisce i contributi degli Stati membri partecipanti al Chapeau e comunica con i servizi della Commissione.

Progetti delle singole imprese

Dimostrare la conformità ai requisiti della comunicazione relativa all'IPCEI a livello di progetto di ciascuna impresa.

Elementi

- Portafoglio progetti (descrizione del singolo progetto)
- Dossier sul gap di finanziamento (proiezioni finanziarie documentate)
- Dossier Prodcom (dati sulla posizione di mercato)



- **Punto 22: Progetti di R & S & I**
- Grande carattere innovativo o
- Importante valore aggiunto oltre lo stato dell'arte globale



*Es. processori e tecnologie dei semiconduttori
fondamentalmente innovativi*



- **Punti 23-24: FID**
- Sviluppo di un nuovo prodotto/servizio ad alto contenuto di R&S oppure
- Implementazione di un processo di produzione fondamentalmente innovativo



Es. lo scaling up delle tecnologie (che richiede R&S)

Misure per le imprese: IPCEI

IPCEI integrati approvati

	Participating companies	Participating projects	State aid approved (EUR billion)	Expected private investments (EUR billion)	Participating Member States
First IPCEI on Microelectronics (2018)	29	43	1,9	6,5	
First IPCEI on Batteries (2019)	17	23	3,2	5	
Second IPCEI on Batteries - EuBatIn (2021)	42	46	2,9	9	
First Hydrogen IPCEI - Hy2Tech (2022)	35	41	5,4	8,8	
Second Hydrogen IPCEI - Hy2Use (2022)	29	35	5,2	7	
Second IPCEI on Microelectronics and Communication Technologies (2023)	56	68	8,1	13,7	
IPCEI on Next Generation Cloud Infrastructure and Services (2023)	19	19	1,2	1,4	
Third Hydrogen IPCEI - Hy2Infra (2024)	32	33	6,9	5,4	
Fourth Hydrogen IPCEI - Hy2Move (2024)	11	13	1,4	3,3	
IPCEI Med4Cure (2024)	13	14	1	5,9	
Total	283 247*	335	37,2	66	22 Member States, UK and Norway participated in at least one IPCEI

*Excluding the companies that participated in more than one IPCEI

Dal 2018, la Commissione ha approvato aiuti di Stato per almeno un IPCEI ogni anno:

- 9 di questi IPCEI riguardano prevalentemente attività di R&S e progetti di prima implementazione industriale (oltre 91 miliardi di euro di aiuti di Stato)
- 1 IPCEI è dedicato alle infrastrutture.

Il crescente numero di aziende provenienti da numerosi Stati membri partecipanti sostiene la creazione di ecosistemi economici europei.

La condivisione del know-how faciliterà ulteriori attività di R&S e dando l'avvio a ulteriori attività economiche nelle catene del valore strategiche dell'UE.

Collaborazione tra Istituzioni, Associazioni e Industrie

- La strategia introdotta in Europa con il Chips Act non può prescindere dal **fare sistema a livello nazionale**, tra dimensione privata e pubblica, industriale e accademica.
- Importante che le azioni indirette di cui possono beneficiare le aziende, come ad esempio quelle tramite **Fondazione CHIPS-IT**, siano messe a terra in modo adeguato e con il coinvolgimento dell'industria e di riflesso delle Associazioni di settore.